

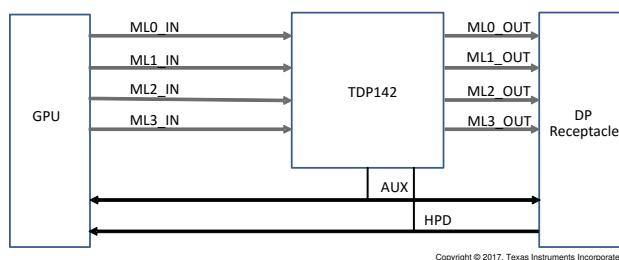
TDP142-Q1 DisplayPort™、8.1Gbps のリニア リドライバ

1 特長

- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
 - 温度: -40°C~105°C、T_A
- DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps (HBR3)
- 超低消費電力アーキテクチャ
- 4.05GHz で最大 12dB のイコライゼーション付きのリニア リドライバ
- DisplayPort™ リンクトレーニングに対して透過的
- GPIO または I²C により設定可能
- ホットプラグ対応
- DisplayPort™ のデュアル モード標準バージョン 1.1 をサポート (AC 結合 HDMI®)
- 7mm × 5mm、0.5mm ピッチの VQFN パッケージで供給

2 アプリケーション

- 後部座席用エンターテインメント
- 車載用ヘッド ユニット
- 車載用インフォテインメントおよびクラスター
- アクティブ ケーブル



概略回路図

Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

3 概要

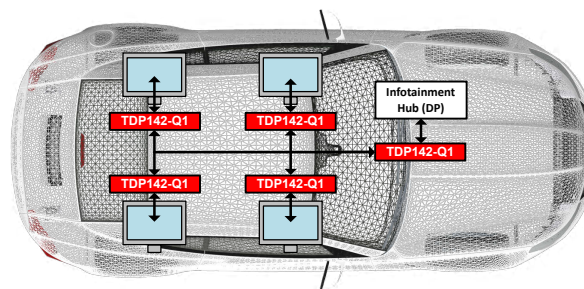
TDP142-Q1 は DisplayPort™ (DP) リニア リドライバで、AUX および HPD 信号をスヌープできます。このデバイスは VESA® DisplayPort™ 標準バージョン 1.4 に準拠し、1~4 レーンのメインリンク インターフェイス信号処理で HBR3 (レーンごとに 8.1Gbps) までをサポートします。さらに、このデバイスは位置に依存せず動作します。TDP142-Q1 はソース、ケーブル、シンクの中に配置でき、リンク バジレット全体に対して実質的に負の損失コンポーネントとして機能します。

TDP142-Q1 は、符号間干渉 (ISI) によるケーブルや基板配線での損失を補償するため、いくつかのレベルで受信リニア イコライゼーションを行えます。TDP142-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
TDP142-Q1	RGF (VQFN, 40)	7mm × 5mm

- 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



アプリケーション使用事例



目次

1 特長	1	6.4 デバイスの機能モード.....	14
2 アプリケーション	1	6.5 プログラミング.....	16
3 概要	1	7 レジスタ マップ	18
4 ピン構成および機能	3	7.1 TDP142-Q1 レジスタ.....	18
5 仕様	5	8 アプリケーションと実装	23
5.1 絶対最大定格.....	5	8.1 アプリケーション情報.....	23
5.2 ESD 定格.....	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	25
5.3 推奨動作条件.....	5	8.3 電源に関する推奨事項.....	28
5.4 熱に関する情報.....	5	8.4 レイアウト.....	29
5.5 電源特性.....	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート	31
5.6 制御 I/O DC の電気的特性.....	6	9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	31
5.7 DP の電気的特性.....	7	9.2 サポート・リソース.....	31
5.8 スイッチング特性.....	8	9.3 商標.....	31
5.9 代表的特性.....	9	9.4 静電気放電に関する注意事項.....	31
6 詳細説明	12	9.5 用語集.....	31
6.1 概要.....	12	10 改訂履歴	31
6.2 機能ブロック図.....	12	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報	31
6.3 機能説明.....	13		

4 ピン構成および機能

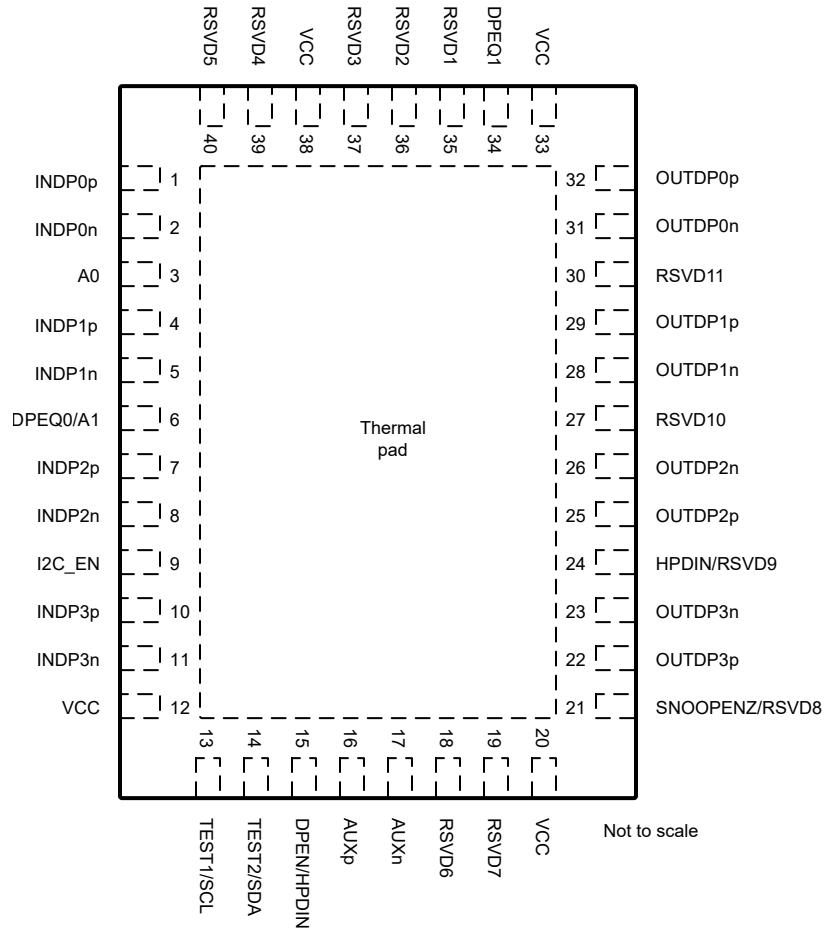


図 4-1. RGF パッケージ 40 ピン (VQFN) 上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン		I/O	説明
名称	番号		
INDP0p	1	I	DisplayPort レーン 0 の DP 差動正入力。
INDP0n	2	I	DisplayPort レーン 0 の DP 差動負入力。
A0	3	4 レベル I	I2C_EN = 0 の場合、ピンを未接続のままにします。I2C_EN が「0」でない場合、このピンは TDP142-Q1 I ² C アドレスも設定します。表 6-4 を参照してください。I2C_EN = 「F」の場合、このピンを「F」または「0」に設定する必要があります。
INDP1p	4	差動 I	DisplayPort レーン 1 の DP 差動正入力。
INDP1n	5	差動 I	DisplayPort レーン 1 の DP 差動負入力。
DPEQ0/A1	6	4 レベル I	DisplayPort レシーバ EQ 制御。これと DPEQ1 は、DisplayPort レシーバのイコライゼーションゲインを選択します。イコライゼーション設定については、表 6-2 を参照してください。I2C_EN が「0」でない場合、このピンは TDP142-Q1 I ² C アドレスも設定します。表 6-4 を参照してください。
INDP2p	7	差動 I	DisplayPort レーン 2 の DP 差動正入力。
INDP2n	8	差動 I	DisplayPort レーン 2 の DP 差動負入力。
I2C_EN	9	4 レベル I	I ² C プログラミング モードまたは GPIO プログラミング選択。I ² C は、このピンが「0」のときのみ無効化します。 0 = GPIO モード (I ² C 無効化)。 R = TI テストモード (I ² C は 3.3V で有効)。 RSVD11 = 「0」かつ RSVD10 = 「0」のとき、F = I ² C は 1.8V で有効になります。それ以外の場合、GPIO モード (I ² C 無効化) 1 = I ² C は 3.3V で有効になります。

表 4-1. ピンの機能 (続き)

ピン		I/O	説明
名称	番号		
INDP3p	10	差動 I	DisplayPort レーン 3 の DP 差動正入力。
INDP3n	11	差動 I	DisplayPort レーン 3 の DP 差動負入力。
VCC	12, 20, 33, 38	P	3.3V 電源。
TEST1/SCL	13	2 レベル I	I2C_EN = 「0」のときは、10k でプルダウンするか、グラウンドに直接接続します。それ以外の場合、このピンは I ² C クロックです。I ² C クロックに使用する場合は、このピンを I ² C コントローラの VCC I ² C 電源にプルアップします。
TEST2/SDA	14	2 レベル I	I2C_EN = 「0」のときは、10k でプルダウンするか、グラウンドに直接接続します。それ以外の場合、このピンは I ² C データです。I ² C データに使用する場合は、このピンを I ² C コントローラの VCC I ² C 電源にプルアップします。
DPEN/HPDIN	15	2 レベル I (フェイルセーフ) (PD)	DP イネーブルピン。I2C_EN = 「0」のとき、このピンは DisplayPort 機能を有効または無効化します。それ以外の場合、I2C_EN が「0」でない場合、DisplayPort 機能は I ² C レジスタにより有効化および無効化されます。 L = DisplayPort 無効化。(10k 抵抗によるプルダウン) H = DisplayPort 有効化。(10k 抵抗によるプルアップ) I2C_EN が「0」でない場合、このピンは DisplayPort シンクから受信されたホットプラグ検出 (HPD) の入力です。この HPDIN が 2ms を超える間 Low になると、すべての DisplayPort レーンが無効化されます。
AUXp	16	I/O, CMOS	このピンと AUXN は、TDP142-Q1 によって AUX スヌーピングに使用されます。詳細については、「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。
AUXn	17	I/O, CMOS	このピンと AUXP は、TDP142-Q1 によって AUX スヌーピングに使用されます。詳細については、「アプリケーションと実装」セクションを参照してください。
RSVD6	18	I/O, CMOS	予約済み。(1)
RSVD7	19	I/O, CMOS	予約済み。(1)
SNOOPENZ/RSVD8	21(2)	I/O (PD)	I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。I2C_EN = 0 の場合、このピンは SNOOPENZ です (L = AUX スヌープは有効化、H = AUX スヌープはすべてのレーンが無効化)。
OUTDP3p	22	差動 O	DisplayPort レーン 3 の DP 差動正出力。
OUTDP3n	23	差動 O	DisplayPort レーン 3 の DP 差動負出力。
HPDIN/RSVD9	24(2)	I/O (PD)	I2C_EN ! = 0 の場合、このピンは予約済みです。I2C_EN = 0 の場合、このピンは DisplayPort シンクから受信したホットプラグ検出の入力です。HPDIN が 2ms を超える間 Low になると、すべての DisplayPort レーンが無効化されます。
OUTDP2p	25	差動 O	DisplayPort レーン 2 の DP 差動正出力。
OUTDP2n	26	差動 O	DisplayPort レーン 2 の DP 差動負出力。
RSVD10	27	I	予約済み。1.8V I ² C を使用する場合は GND に接続します。それ以外の場合、ピンはフローティングのままにします。
OUTDP1n	28	差動 O	DisplayPort レーン 1 の DP 差動負出力。
OUTDP1p	29	差動 O	DisplayPort レーン 1 の DP 差動正出力。
RSVD11	30	I	予約済み。1.8V I ² C を使用する場合は GND に接続します。それ以外の場合、ピンはフローティングのままにします。
OUTDP0n	31	差動 O	DisplayPort レーン 0 の DP 差動負出力。
OUTDP0p	32	差動 O	DisplayPort レーン 0 の DP 差動正出力。
DPEQ1	34	4 レベル I	DisplayPort レシーバ EQ 制御。これと DPEQ0 は、DisplayPort レシーバのイコライゼーションゲインを選択します。イコライゼーション設定については、表 6-2 を参照してください。
RSVD1	35	I	予約済み。(1)
RSVD2	36	O	予約済み。(1)
RSVD3	37	O	予約済み。(1)
RSVD4	39	I	予約済み。(1)
RSVD5	40	I	予約済み。(1)

(1) PCB 上では未接続のままにします。

(2) フェイルセーフ I/O ではない。VCC が除去された状態でピンを積極的に High に駆動すると、VCC ピンにリーク電圧が発生します。

5 仕様

5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) ⁽¹⁾

		最小値	最大値	単位
電源電圧範囲	V _{CC}	-0.3	4	V
任意の入力または出力ピンの電圧範囲	正入力と負入力との間の差動電圧	-2.5	2.5	V
	差動入力での電圧	-0.5	4	V
	CMOS 入力	-0.5	4	V
最大接合部温度、T _J		-40	125	°C
保管温度、T _{stg}		-65	150	°C

(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。

5.2 ESD 定格

		値	単位
V _(ESD)	静電放電		V
	人体モデル (HBM)、AEC Q100-002 ⁽¹⁾ に準拠、すべてのピン	±2000	
	デバイス帯電モデル (CDM)、AEQ Q100-011 に準拠、すべてのピン	±1500	

(1) AEC Q100-002 は、HBM ストレス試験を ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 仕様に従って実施しなければならないと規定しています。

5.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	公称値	最大値	単位
V _{CC}	メイン電源	3.0	3.3	3.6	V
	メイン電源ランプ要件	0.1		50	ms
V _(I2C)	SDA と SCL に外部抵抗をプルアップする電源	1.7		3.6	V
V _(PSN)	V _{CC} ピンの電源ノイズ (4MHz 未満)			100	mV
T _A	自由空気での動作温度	-40		105	°C
T _{PCB}	PCB 温度 (デバイスから 1mm 離れた場所)	-40		112	°C

5.4 熱に関する情報

熱評価基準 ⁽¹⁾		デバイス	単位
		RGF (VQFN)	
		40 ピン	
R _{θJA}	接合部から周囲への熱抵抗	29.4	°C/W
R _{θJC(top)}	接合部からケース (上面) への熱抵抗	18.9	°C/W
R _{θJB}	接合部から基板への熱抵抗	11.0	°C/W
ψ _{JT}	接合部から上面への特性パラメータ	0.3	°C/W
ψ _{JB}	接合部から基板への特性パラメータ	10.9	°C/W
R _{θJC(bot)}	接合部からケース (底面) への熱抵抗	3.6	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション ノートを参照してください。

5.5 電源特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
$P_{CC(ACTIVE-4DP)}$	平均アクティブ電力 (4 レーン DP のみ)	8.1Gbps で動作時の 4 つのアクティブな DP レーン、PRBS7 パターン、 DPEN = H、LINR_L3、		500		mW
$P_{CC(HPDLOW-4DP)}$	HPDIN = L の場合の 4 レーン DP の みの電力	DPEN = H、HPDIN = L、		0.475		mW
$P_{CC(DISABLED-I2C)}$	I ² C モードでのデバイスの無効電力	I2C_EN ! = 0、HPDIN = L、CTLSEL = 0x0、		0.122		mW
$P_{CC(DISABLED)}$	デバイスの無効電力	DPEN = L、I2C_EN = 0、HPDIN = L、		0.110		mW

5.6 制御 I/O DC の電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
4 レベル入力						
I_{IH}	High レベル入力電流	$V_{CC} = 3.6V$ 、 $V_{IN} = 3.6V$	20		60	μA
I_{IL}	Low レベル入力電流	$V_{CC} = 3.6V$ 、 $V_{IN} = 0V$	-100		-40	μA
4 レベル V_{TH}	スレッショルド 0/R	$V_{CC} = 3.3V$		0.55		V
4 レベル V_{TH}	スレッショルド R/Float	$V_{CC} = 3.3V$		1.65		V
4 レベル V_{TH}	スレッショルド Float/1	$V_{CC} = 3.3V$		2.7		V
R_{PU}	内部プルアップ抵抗			48		k Ω
R_{PD}	内部プルダウン抵抗			98		k Ω
2 ステート CMOS 入力						
V_{IH}	High レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.0V$	2		3.6	V
V_{IL}	Low レベル入力電圧	$V_{CC} = 3.6V$	0		0.8	V
R_{PD}	HPDIN、CADSNK の内部プルダウン抵抗		300	500	600	k Ω
R_{PD}	DPEN の内部プルダウン抵抗		300	500	600	k Ω
I_{IH_DPEN}	DPEN の High レベル入力電流	$V_{IN} = 3.6V$	-12		12	μA
I_{IL_DPEN}	DPEN の Low レベル入力電流	$V_{IN} = GND$ 、 $V_{CC} = 3.6V$	-1		1	μA
$I_{IH_HPD_CAD}$	HPDIN、CADSNK の High レベル入力電流	$V_{IN} = 3.6V$	-11		11	μA
$I_{IL_HPD_CAD}$	HPDIN、CADSNK の Low レベル入力電流	$V_{IN} = GND$ 、 $V_{CC} = 3.6V$	-1		1	μA
I²C 制御ピン (SCL、SDA)						
V_{IH_3p3V}	3.3V の I ² C レベルに構成したときの High レベル 入力電圧	I2C_EN = 1	2.0		3.6	V
V_{IL_3p3V}	3.3V の I ² C レベルに構成したときの Low レベル入 力電圧	I2C_EN = 1	0		0.8	V
V_{IH_1p8V}	1.8V の I ² C レベルに構成したときの High レベル 入力電圧	I2C_EN = F	1.2			V
V_{IL_1p8V}	1.8V の I ² C レベルに構成したときの Low レベル入 力電圧	I2C_EN = F	0		0.6	V
V_{OL}	Low レベル出力電圧	I2C_EN = 0、 $I_{OL} = 6mA$	0		0.4	V
I_{OL}	Low レベル出力電流	I2C_EN = 0、 $V_{OL} = 0.4V$	20			mA
$I_{I(I2C)}$	入力電流	$0.1 \times V_{(I2C)} < \text{入力電圧} < 3.3V$	-1		1	μA
$C_{I(I2C)}$	入力容量				10	pF
$C_{(I2C_FM+_BUS)}$	FM+(1MHz) での I ² C バス容量				150	pF
$C_{(I2C_FM_BUS)}$	FM (400kHz) での I ² C バス容量				150	pF
$R_{(EXT_I2C_FM+)}$	FM+(1MHz) で動作時の SDA と SCL の両方の外 付け抵抗	$C_{(I2C_FM+_BUS)} = 150pF$	620	820	910	Ω
$R_{(EXT_I2C_FM)}$	FM+(400kHz) で動作時の SDA と SCL の両方の 外付け抵抗	$C_{(I2C_FM_BUS)} = 150pF$	620	1500	2200	Ω

5.7 DP の電気的特性

自由気流での動作温度および電圧範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
AC の特性						
CP _{LF-LINRL0}	LINR_L0 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。	100MHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		750		mVppd
CP _{HF-LINRL0}	LINR_L0 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。	5GHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		675		mVppd
CP _{LF-LINRL1}	LINR_L1 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。	100MHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		850		mVppd
CP _{HF-LINRL1}	LINR_L1 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。	5GHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		740		mVppd
CP _{LF-LINRL2}	LINR_L2 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。	100MHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		975		mVppd
CP _{HF-LINRL2}	LINR_L2 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。	5GHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		800		mVppd
CP _{LF-LINRL3}	LINR_L3 設定時の低周波数における -1dB 圧縮ポイント。	100MHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		1050		mVppd
CP _{HF-LINRL3}	LINR_L3 設定時の高周波数における -1dB 圧縮ポイント。	5GHz, 200mVpp < V _{ID} < 1200mVpp, EQ = 0		775		mVppd
t _{TX-DJ}	TX 出力の確定的残留ジッタ	VID = 0.8Vppd、最適な EQ 設定、12 インチ プリチャネル (5GHz で SDD21 = -8.2dB)、1.6 インチ ポスト チャネル (5GHz で SDD21 = -1.8dB)、PRBS7、8.1Gbps で DP		0.06		UI
DisplayPort レシーバ						
V _{ID(PP)}	ピーク ツー ピークの入力差動ダイナミック電圧範囲			1400		V
V _{IC}	入力同相電圧		0.8	1.75	2	V
V _{RX-CM-INST}	次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化: オフからオン、ディスエーブルから 4DP 低電力、4DP アクティブからディスエーブル。(1)	200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。	-1200		1000	mV
V _{RX-CM-INST}	次の動作状態での最大瞬時 RX DC 同相電圧変化: ディスエーブルから 4DP アクティブ (D0)、D0 から D3、D3 から D0。	50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側でシングル エンドを測定。	-500		1000	mV
d _R	データレート				8.1	Gbps
R _(ti)	入力終端抵抗		72	90	110	Ω
C _(AC)	必須の外付け AC カップリング コンデンサ		75		265	nF
E _{Q-DP0}	100MHz での DP0 レシーバ イコライゼーション	DP0EQ_SEL = 0、		-0.2		dB
E _{Q-DP15}	100MHz での DP0 レシーバ イコライゼーション	DP0EQ_SEL = 15		2.3		dB
E _{Q-DP0}	4.05GHz での DP0 レシーバ イコライゼーション	DP0EQ_SEL = 0、		0.6		dB
E _{Q-DP15}	4.05GHz での DP0 レシーバ イコライゼーション	DP0EQ_SEL = 15		14.5		dB
DisplayPort トランスミッタ						
V _{TX-CM-INST}	次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化: ディスエーブルから 4DP アクティブ (D0)、D0 から D3、D3 から D0。	50Ω 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。	-500		1000	mV
V _{TX-CM-INST}	次の動作状態での最大瞬時 TX DC 同相電圧変化: ディスエーブルから 4DP 低電力、4DP アクティブからディスエーブル	200kΩ 負荷を使用して、AC 結合コンデンサのリドライバ以外の側で測定。	-1000		1000	mV
V _{TX(DC-CM)}	トランスミッタの同相電圧バイアス (DC)		0.6		1	V

自由気流での動作温度および電圧範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
R _{TX(DIFF)}	ドライバの差動インピーダンス		72	90	120	Ω

(1) DPTX 終端を無効にする前にリドライバを無効にすることで、GPU (DPTX) が観測する瞬間的な同相変位を最小化できます。

5.8 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
HPDIN						
t _{HPDIN_DEBOUNCE}	H から L に遷移するときの DPEN および HPDIN デバウンス時間。		2		10	ms
I²C						
f _{SCL}	I ² C クロック周波数				1	MHz
t _{BUF}	START 条件と STOP 条件の間でのバス開放時間	図 6-1 を参照してください	0.5			μs
t _{HDSTA}	リピート スタート コンディションの後のホールド時間。この時間が経過すると、最初のクロックパルスが生成されます	図 6-1 を参照してください	0.26			μs
t _{LOW}	I ² C クロックの Low 期間	図 6-1 を参照してください	0.5			μs
t _{HIGH}	I ² C クロックの High 期間	図 6-1 を参照してください	0.26			μs
t _{SUSTA}	反復開始条件のセットアップ時間	図 6-1 を参照してください	0.26			μs
t _{HDDAT}	データ ホールド時間	図 6-1 を参照してください	0.008			μs
t _{SUDAT}	データ セットアップ時間	図 6-1 を参照してください	50			ns
t _R	SDA 信号と SCL 信号の両方の立ち上がり時間	図 6-1 を参照してください			120	ns
t _F	SDA 信号と SCL 信号の両方の立ち下がり時間	図 6-1 を参照してください	1.2		120	ns
t _{SUSTO}	停止条件のセットアップ時間	図 6-1 を参照してください	0.26			μs
C _b	各バスラインの容量性負荷				150	pF

5.9 代表的特性

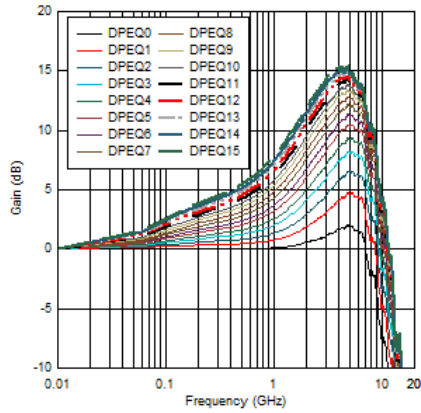


図 5-1. DisplayPort EQ 設定曲線

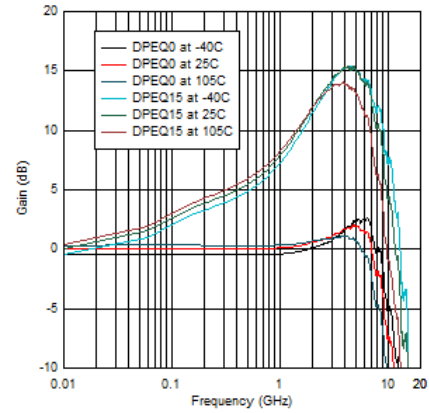


図 5-2. 温度範囲全体にわたる DisplayPort EQ 設定曲線

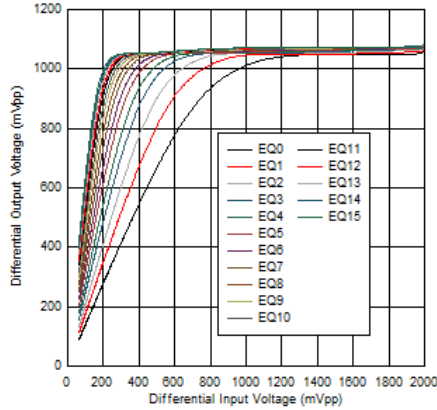


図 5-3. 4.05GHz での DisplayPort 直線性曲線

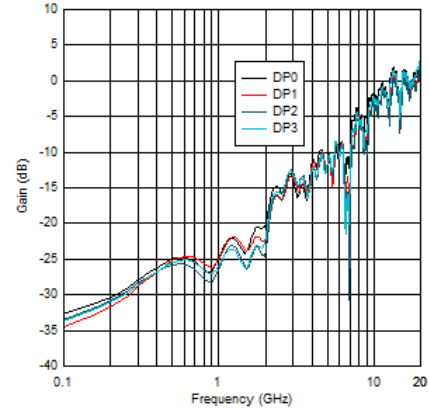


図 5-4. DisplayPort 入力のリターン ロス性能

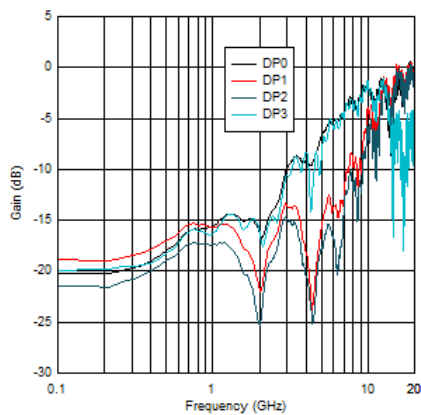


図 5-5. DisplayPort 出力のリターン ロス性能

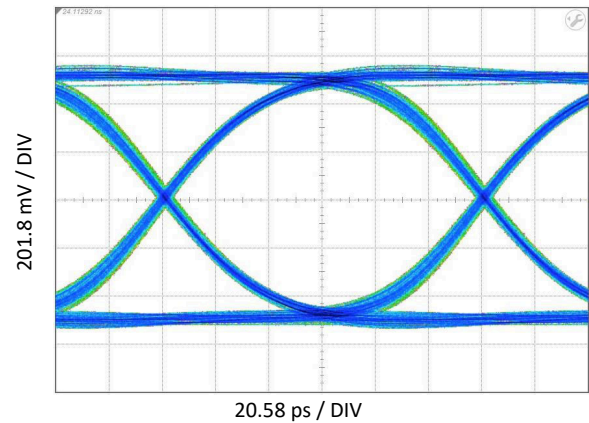


図 5-6. 8.1Gbps での 12 インチ入力 PCB トレースによる DisplayPort HBR3 のアイパターン性能

5.9 代表的特性 (続き)

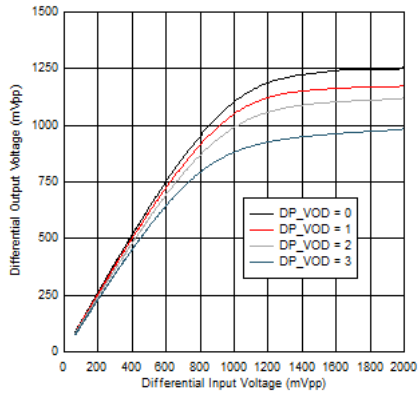


図 5-7. 100MHz での DP VOD 直線性設定

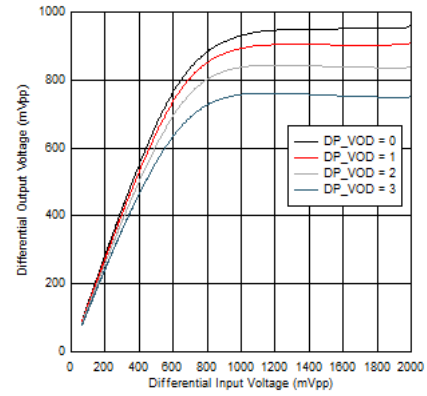


図 5-8. 5GHz での DP VOD 直線性設定

パラメータ測定情報

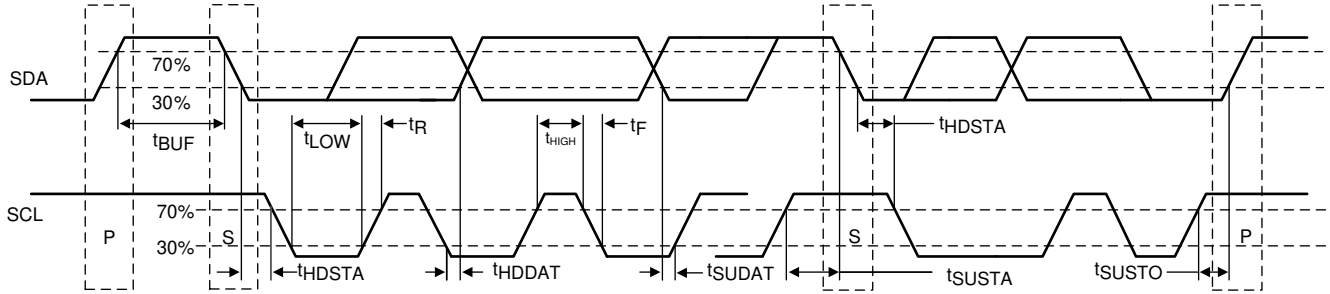


図 6-1. I²C のタイミング図の定義

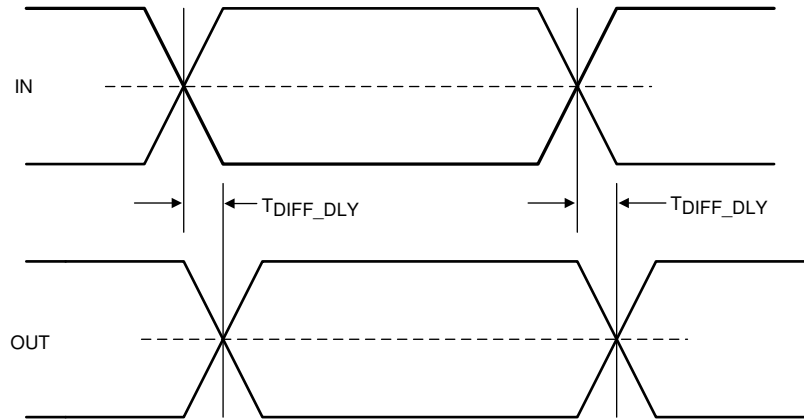


図 6-2. 伝搬遅延

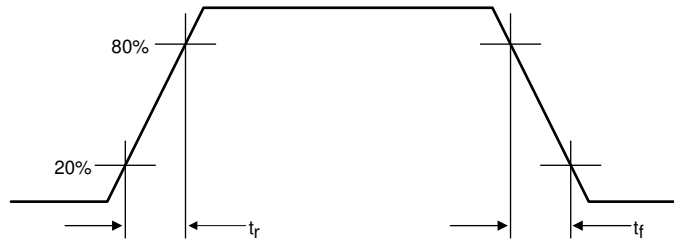


図 6-3. 出力の立ち上がりおよび立ち下がり時間

6 詳細説明

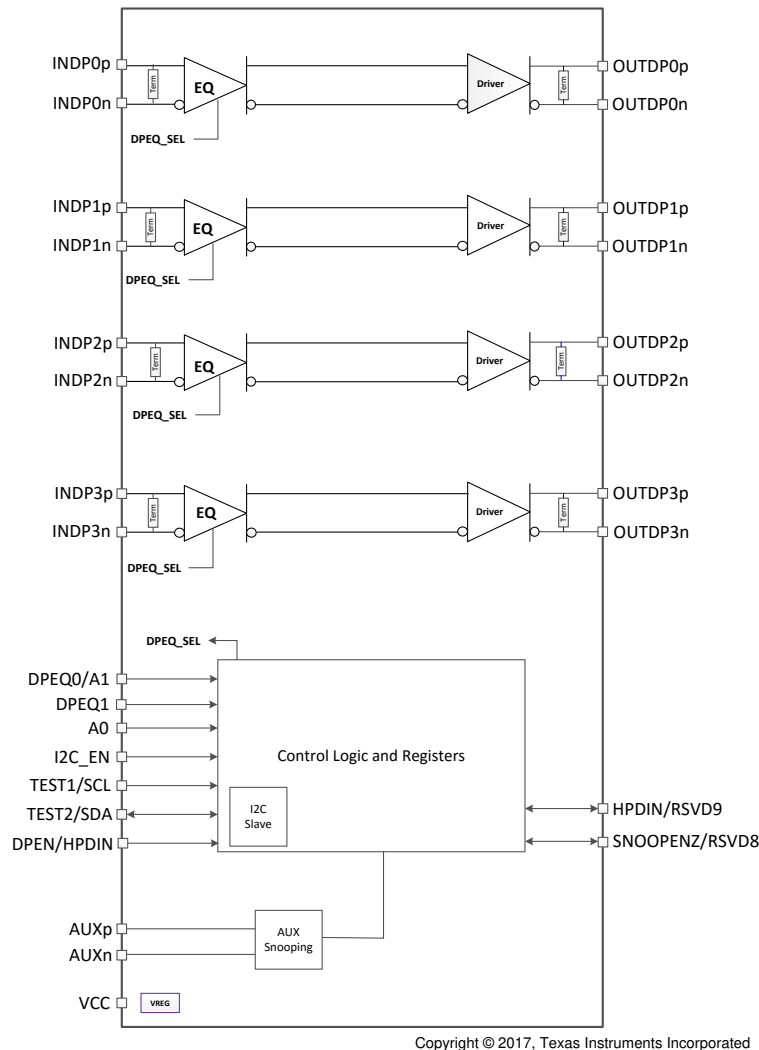
6.1 概要

TDP142-Q1 は、各レーンで最大 8.1Gbps をサポートする DisplayPort リニア リドライバです。また、デバイスの DP リンクトレーニングへの透過性により、TDP142-Q1 はソース / シンクまたはケーブル アプリケーション用に設計された位置に依存しないデバイスとなります。

TDP142-Q1 は、システムが DisplayPort バージョン 1.4 HBR3 のトランスミッタとレシーバの両方の準拠に合格するために役立ちます。リドライバは、チャンネル損失を補償するイコライゼーションを適用して入力データを回復し、高い差動電圧で信号を駆動します。各チャンネルにはレシーバ イコライザがあり、ゲイン設定を選択可能です。TDP142-Q1 レシーバ前の挿入損失量に基づいてイコライゼーションを設定します。イコライゼーション制御は、DPEQ[1:0] ピンまたは I²C レジスタで制御できます。

このデバイスの超低消費電力アーキテクチャは、3.3V の電源で動作し、性能向上を実現しています。また、TDP142-Q1 には商業用温度範囲と工業用温度範囲があります。

6.2 機能ブロック図



6.3 機能説明

6.3.1 DisplayPort

TDP142-Q1 は、最高 8.1 Gbps (HBR3) のデータ速度で最大 4 つの DisplayPort レーンをサポートします。TDP142-Q1 は、デバイスが DisplayPort ソースと DisplayPort シンクの間を通過するときに、ネイティブ AUX トラフィックを監視します。消費電力を低減するために、TDP142-Q1 は AUX トランザクションの内容に基づいてアクティブな DisplayPort レーン数を管理します。TDP142-Q1 は、DisplayPort シンクの DPCD レジスタ 0x00101 (LANE_COUNT_SET) および 0x00600 (SET_POWER_STATE) へのネイティブ AUX 書き込みをスヌープします。TDP142-Q1 は、LANE_COUNT_SET に書き込まれた値に基づいてレーンを無効化または有効化します。SET_POWER_STATE が D3 のとき、TDP142-Q1 はすべてのレーンを無効化します。それ以外の場合、アクティブなレーンは LANE_COUNT_SET の値に基づいています。

DisplayPort AUX スヌーピングは、デフォルトで有効になっていますが、AUX_SNOOP_DISABLE レジスタを変更することで無効化することもできます。AUX スヌープが無効化されている場合、TDP142-Q1 DisplayPort レーンは各種の構成レジスタで制御されます。TDP142-Q1 が GPIO モード (I2C_EN =「0」) で有効にされているとき、SNOOPENZ ピンを使用して AUX スヌーピングを無効化することができます。SNOOPENZ ピンが High のとき、AUX スヌーピング機能が無効化され、4 つの DisplayPort レーンすべてがアクティブになります。

6.3.2 構成ジャンパレベル

TDP142-Q1 評価基板は、4 レベル入力ピン (I2C_EN、A0、DPEQ[1:0]) を備えており、これはイコライゼーションゲインを制御し、TDP142-Q1 をさまざまな動作モードに設定するために使用できます。これらの 4 レベル入力は、4 つの有効なレベルを設定するために抵抗デバイダを使用しており、制御設定範囲を広げることができます。内部プルアップおよびプルダウン抵抗があり、外付け抵抗の接続と組み合わせることで目的の電圧レベルを達成できます。

表 6-1. 4 レベル構成のジャンパ設定

レベル	設定
Low	1kΩ 5% を GND に接続します。
R	20kΩ 5% を GND に接続します。
F	フロート (ピンはオープンのままにする)
High	1kΩ 5% を V _{CC} に接続します。

注

すべての 4 レベル入力は、内部リセットの立ち上がりエッジでラッチされます。t_{CFG_HD} の後、消費電力を削減するため、内部プルアップおよびプルダウン抵抗を絶縁します。

6.3.3 レシーバのリニアイコライゼーション

レシーバのイコライゼーションは、TDP142-Q1 の入力前にシステムでのチャネル挿入損失とシンボル間干渉を補償することを目的としています。レシーバは、高周波成分を基準として信号の低周波数成分を減衰させることで、これらの損失を克服します。TDP142-Q1 レシーバの入力前のチャネル挿入損失に対応するように、適切なゲイン設定を選択します。2 本の 4 レベル入力ピンにより、最大 16 件のイコライゼーション設定が可能です。また、TDP142-Q1 は、I²C レジスタを介して設定を柔軟に調整できます。

6.4 デバイスの機能モード

6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成

TDP142-Q1 は、I2C_EN =「0」のとき、GPIO 構成です。DPEN ピンは DisplayPort を有効にするかどうかを制御し、SNOOPENZ ピンは AUX スヌープ モードを有効にするかどうかを制御します。

6.4.2 I²C モードでのデバイス構成

TDP142-Q1 は I2C_EN が「0」と等しくない場合、I²C モードになります。GPIO モードで定義されているのと同じ構成が、I²C モードでも使用できます。TDP142-Q1 DisplayPort の構成は、[プログラミング](#)セクションに基づいてプログラムされます。

6.4.3 リニア EQ の構成

レーザバのイコライゼーション ゲイン値は、I²C レジスタまたは GPIO のどちらかにより制御可能です。TDP142-Q1 が GPIO モードの場合、利用可能な各組み合わせのゲイン値の詳細を [表 6-2](#) に示します。I²C モードでは、レジスタ DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL を更新することにより、同じオプションまたは個別のレーン EQ 設定を行うこともできます。

表 6-2. TDP142-Q1 レーザバのイコライゼーション制御

レジスタ (S): DP0EQ_SEL、DP1EQ_SEL、 DP2EQ_SEL、DP3EQ_SEL イコライゼーション設定 #	DPEQ1 ピンレベル	DPEQ0 ピンレベル	2.7/4.05/5GHz での EQ ゲイン 100MHz での 負のゲイン (dB)
0	0	0	0.4/0.8/0.83
1	0	R	2.0/3.1/3.4
2	0	F	3.0/4.6/5.0
3	0	1	4.2/6.0/6.5
4	R	0	5.0/7.0/7.5
5	R	R	6.0/8.0/8.4
6	R	F	6.5/8.7/9.1
7	R	1	7.2/9.4/9.8
8	F	0	7.8/10.0/10.3
9	F	R	8.3/10.4/10.7
10	F	F	8.7/10.7/10.9
11	F	1	9.1/11.1/11.2
12	1	0	9.4/11.3/11.3
13	1	R	9.7/11.5/11.5
14	1	F	10.0/11.7/11.6
15	1	1	10.2/11.8/11.7

6.4.4 動作タイミング– パワーアップ

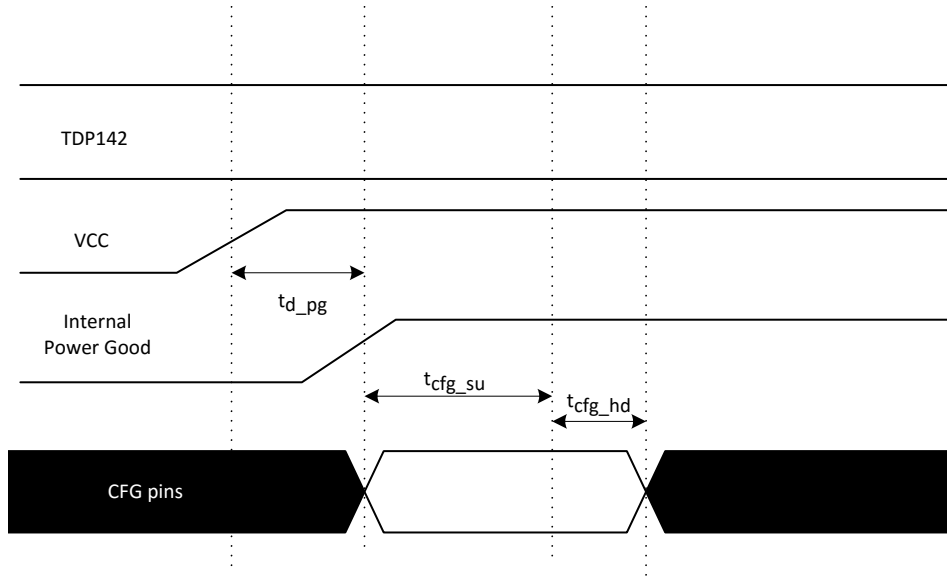


図 6-1. パワーアップのタイミング

表 6-3. パワーアップのタイミング (1) (2)

パラメータ		最小値	最大値	単位
t_{d_pg}	V_{CC} (最小値) から内部パワー グッドが High にアサートされるまで		500	μs
t_{cfg_su}	CFG ⁽¹⁾ ピンの設定 ⁽²⁾	50		μs
t_{cfg_hd}	CFG ⁽¹⁾ ピン ホールド	10		μs
t_{VCC_RAMP}	V_{CC} 電源ランプ要件		100	ms

- (1) 以下のピンは CFG ピンで構成されます。I2C_EN、DPEQ[1:0]。
 (2) 推奨される CFG ピンは、 V_{CC} が最小のとき安定するようにしてください。

6.5 プログラミング

さらにプログラマビリティを高めるため、I²C を使用して TDP142-Q1 を制御できます。I2C_EN != 0 の場合、SCL ピンと SDA ピンは、それぞれ I²C クロックと I²C データに使用されます。

表 6-4. TDP142-Q1 の I²C ターゲット アドレス

DPEQ0/A1 ピンレベル	A0 ピンレベル	ビット 7 (MSB)	ビット 6	ビット 5	ビット 4	ビット 3	ビット 2	ビット 1	ビット 0 (W/R)
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0/1
0	R	1	0	0	0	1	0	1	0/1
0	F	1	0	0	0	1	1	0	0/1
0	1	1	0	0	0	1	1	1	0/1
R	0	0	1	0	0	0	0	0	0/1
R	R	0	1	0	0	0	0	1	0/1
R	F	0	1	0	0	0	1	0	0/1
R	1	0	1	0	0	0	1	1	0/1
F	0	0	0	1	0	0	0	0	0/1
F	R	0	0	1	0	0	0	1	0/1
F	F	0	0	1	0	0	1	0	0/1
F	1	0	0	1	0	0	1	1	0/1
1	0	0	0	0	1	1	0	0	0/1
1	R	0	0	0	1	1	0	1	0/1
1	F	0	0	0	1	1	1	0	0/1
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0/1

TDP142-Q1 I²C レジスタに書き込むには、次の手順を使用します。

1. コントローラが START 条件 (S) を生成して書き込み動作を開始し、TDP142-Q1 の 7 ビット アドレスと 0 値「W/R」ビットを送信して書き込みサイクルを示します。
2. TDP142-Q1 が、アドレス サイクルをアックノリッジ (受信確認) します。
3. コントローラが 1 バイトのデータ (MSB ファースト) で構成された書き込むサブアドレス (TDP142-Q1 内の I²C レジスタ) を送信します。
4. TDP142-Q1 が、サブアドレス サイクルをアックノリッジ (受信確認) します。
5. コントローラが I²C レジスタに書き込むデータの最初のバイトを送信します。
6. TDP142-Q1 が、バイト転送をアックノリッジします。
7. コントローラが書き込むデータの追加のバイトを送信し続けます。各バイト転送は、TDP142-Q1 からのアックノリッジで完了します。
8. コントローラが STOP 条件 (P) を生成して書き込み動作を終了します。

TDP142-Q1 I²C レジスタを読み出すには、次の手順を使用します。

1. コントローラが開始条件 (S) を生成して読み出し動作を開始し、TDP142-Q1 の 7 ビット アドレスと 1 値「R」ビットを送信して読み出しサイクルを示します。
2. TDP142-Q1 が、アドレス サイクルをアックノリッジ (受信確認) します。
3. TDP142-Q1 は、レジスタ 00h または最後の読み出しサブアドレス + 1 から、メモリ レジスタの内容を MSB ファーストで送信します。読み出しの前に T I²C レジスタへの書き込みが発生した場合、TDP142-Q1 は書き込みで指定されたサブアドレスから開始します。
4. TDP142-Q1 は、各バイト転送の後、コントローラからのアックノリッジ (ACK) または非アックノリッジ (NACK) を待ちます。I²C コントローラは、各データ バイト転送の受信をアックノリッジします。
5. TDP142-Q1 は、ACK を受信するとデータの次のバイトを送信します。
6. コントローラが STOP 条件 (P) を生成して読み出し動作を終了します。

I²C 読み出しの開始サブアドレスを設定するには、次の手順を使用します。

1. コントローラが **START** 条件 (S) を生成して書き込み動作を開始し、TDP142-Q1 の 7 ビットアドレスと 0 値「W/R」ビットを送信して書き込みサイクルを示します。
2. TDP142-Q1 が、アドレス サイクルをアクリッジ (受信確認) します。
3. コントローラが 1 バイトのデータ (MSB ファースト) で構成された書き込むサブアドレス (TDP142-Q1 内の I²C レジスタ) を送信します。
4. TDP142-Q1 が、サブアドレス サイクルをアクリッジ (受信確認) します。
5. コントローラが **STOP** 条件 (P) を生成して書き込み動作を終了します。

注

読み出し手順にサブアドレス指定が含まれていない場合、読み出しはレジスタ オフセット 00h から開始し、I²C コントローラが読み出し動作を終了するまでレジスタの内容をバイト単位で送信します。読み出しの前に I²C レジスタへの書き込みが発生した場合、読み出しはアドレス書き込みで指定されたサブアドレスから開始します。

表 6-5. レジスタ凡例

アクセス タグ	名称	意味
R	読み出し	このフィールドは、ソフトウェアで読み出すことができます
W	書き込み	このフィールドは、ソフトウェアで書き込むことができます
S	設定	このフィールドは、1 を書き込むことで設定できます。フィールドにゼロを書き込んでも影響はありません。
C	わかりやすい	このフィールドは、1 を書き込むことでクリアできます。フィールドにゼロを書き込んでも影響はありません。
U	更新	ハードウェアはこのフィールドを自動的に更新できます。
該当なし	アクセスなし	アクセス不可または該当なし

7 レジスタ マップ

7.1 TDP142-Q1 レジスタ

表 7-1 に、TDP142-Q1 レジスタの一覧を示します。表 7-1 にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なし、レジスタの内容は変更しないでください。

表 7-1. TDP142-Q1 レジスタ

オフセット	略称	レジスタ名	セクション
0xA	General_1	汎用レジスタ	表示
0x10	DP01EQ_SEL	DisplayPort レーン 0 および 1 EQ 制御	表示
0x11	DP23EQ_SEL	DisplayPort レーン 2 および 3 EQ 制御	表示
0x12	DisplayPort_1	AUX スヌープ ステータス	表示
0x13	DisplayPort_2	DP レーン有効化 / 無効化制御	表示
0x32	VOD_CTRL	VOD の直線性	表示

表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 7-2 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。

表 7-2. TDP142-Q1 のアクセス タイプ コード

アクセス タイプ	表記	概要
読み取りタイプ		
R	R	読み出し
RH	R H	ハードウェアによってセットまたはクリアされる の読み取り
書き込みタイプ		
W	W	書き込み
W1S	W 1S	1 を書き込むことで セット
WS	W	書き込み
リセットまたはデフォルト値		
-n		リセット後の値またはデフォルト値

7.1.1 General_1 レジスタ (オフセット = 0xA) [リセット = 0x1]

General_1 を表 7-3 に示します。

概略表に戻ります。

このレジスタは、無効化モードと DisplayPort モードのどちらかを選択するために使用します。ソフトウェアは EQ_OVERRIDE ビットを設定し、ピンの代わりに EQ レジスタを使用することができます。

表 7-3. General_1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7	RESERVED	R/W	0x0	予約済み
6	RESERVED	R	0x0	予約済み

表 7-3. General_1 レジスタのフィールドの説明 (続き)

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
5	SWAP_HPDIIN	R/W	0x0	HPDIIN がどのピンから派生するかを制御します。 0x0 = HPDIIN はデフォルト位置にあります 0x1 = HPDIIN 位置が交換されます (ピン 23 からピン 32 へ、またはピン 32 からピン 23 へ)。
4	EQ_OVERRIDE	R/W	0x0	このフィールドを設定すると、ソフトウェアはピンからサンプリングされた値ではなく、レジスタからの EQ 設定を使用できます。 0x0 = EQ ピンのサンプリングされた状態に基づく EQ 設定。 0x1 = 各 EQ レジスタにプログラムされた値に基づく EQ 設定。
3	HPDIIN_OVERRIDE	R/W	0x0	HPDIIN ピンの状態をオーバーライドします。 0x0 = HPDI_IN ピンに基づく HPDI_IN 0x1 = HPDI_IN High。
2	RESERVED	R/W	0x0	RESERVED
1-0	CTLSEL	R/W	0x1	電源オン時、ソフトウェアは 0x2 を書き込んで DisplayPort 機能を有効にする必要があります。DisplayPort 機能が不要な場合、ソフトウェアは 0x0 を書き込んで DisplayPort を無効化する必要があります 0x0 = ディスエーブル。DP がディスエーブルで、最小消費電力状態 0x1 = DP はディスエーブルだが、最小消費電力状態ではない。 0x2 = DisplayPort はイネーブル。 0x3 = 予約済み

7.1.2 DP01EQ_SEL レジスタ (オフセット = 0x10) [リセット = 0x0]

DP01EQ_SEL を表 7-4 に示します。

概略表に戻ります。

このレジスタは、DisplayPort レシーバ 0 および 1 のレシーバ イコライゼーション設定を制御します。

表 7-4. DP01EQ_SEL レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7-4	DP1EQ_SEL	RH/W	0x0	フィールドは DP レーン 1 ピンの EQ を選択します。EQ_OVERRIDE = 0b の場合、このフィールドは DPEQ[1:0] ピンのサンプリングされた状態を反映します。EQ_OVERRIDE = 1b のとき、ソフトウェアはこのフィールドに書き込まれた値に基づいて DP レーン 1 の EQ 設定を変更できます。
3-0	DP0EQ_SEL	RH/W	0x0	フィールドは DP レーン 0 ピンの EQ を選択します。EQ_OVERRIDE = 0b の場合、このフィールドは DPEQ[1:0] ピンのサンプリングされた状態を反映します。EQ_OVERRIDE = 1b のとき、ソフトウェアはこのフィールドに書き込まれた値に基づいて DP レーン 0 の EQ 設定を変更できます。

7.1.3 DP23EQ_SEL レジスタ (オフセット = 0x11) [リセット = 0x0]

DP23EQ_SEL を表 7-5 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

このレジスタは、DisplayPort レシーバ 2 および 3 のレシーバ イコライゼーション設定を制御します。

表 7-5. DP23EQ_SEL レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7-4	DP3EQ_SEL	RH/W	0x0	フィールドは DP レーン 3 ピンの EQ を選択します。EQ_OVERRIDE = 0b の場合、このフィールドは DPEQ[1:0] ピンのサンプリングされた状態を反映します。EQ_OVERRIDE = 1b のとき、ソフトウェアはこのフィールドに書き込まれた値に基づいて DP レーン 3 の EQ 設定を変更できます。
3-0	DP2EQ_SEL	RH/W	0x0	フィールドは DP レーン 2 ピンの EQ を選択します。EQ_OVERRIDE = 0b の場合、このフィールドは DPEQ[1:0] ピンのサンプリングされた状態を反映します。EQ_OVERRIDE = 1b のとき、ソフトウェアはこのフィールドに書き込まれた値に基づいて DP レーン 2 の EQ 設定を変更できます。

7.1.4 DisplayPort_1 レジスタ (オフセット = 0x12) [リセット = 0x0]

DisplayPort_1 を表 7-6 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

このレジスタは、AUX スヌーピングを有効にするときの AUX スヌーピングのステータスを示します。

表 7-6. DisplayPort_1 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7	RESERVED	R	0x0	予約済み
6-5	SET_POWER_STATE	RH	0x0	このフィールドは、DPCD アドレス 0x00600 への AUX 書き込みのスヌーピング値を表します。AUX_SNOOP_DISABLE = 0b のとき、スヌーピング値に基づいて DP レーンをイネーブルまたはディスエーブルにします。AUX_SNOOP_DISABLE = 1b の場合、DP レーンのイネーブル/ディスエーブルは DPx_DISABLE レジスタの状態によって決定されます。ここで、x = 0、1、2、または 3 です。CTLSEL1 が 1b から 0b に変化すると、このフィールドはハードウェアによって 0h にリセットされます。
4-0	LANE_COUNT_SET	RH	0x0	このフィールドは、DPCD アドレス 0x00101 レジスタへの AUX 書き込みのスヌーピング値を表します。AUX_SNOOP_DISABLE = 0b のとき、スヌーピング値で指定された DP レーンをイネーブルにします。未使用の DP レーンは、電力を節約するためディスエーブルされます。AUX_SNOOP_DISABLE = 1b の場合、DP レーンのイネーブル/ディスエーブルは DPx_DISABLE レジスタによって決定されます。ここで、x = 0、1、2、または 3 です。CTLSEL1 が 1b から 0b に変化すると、このフィールドはハードウェアによって 0h にリセットされます。

7.1.5 DisplayPort_2 レジスタ (オフセット = 0x13) [リセット = 0x0]

DisplayPort_2 を表 7-7 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

このレジスタを使用すると、AUX スヌーピングと個別の DP レーンのイネーブルとディスエーブルを制御できます。

表 7-7. DisplayPort_2 レジスタのフィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7	AUX_SNOOP_DISABLE	R/W	0x0	AUX スヌーピング値またはレジスタに基づいて DP レーンを有効にするかどうかを制御します。 0x0 = AUX スヌープは有効です。 0x1 = AUX スヌープは無効化されます。DP レーンはレジスタによって制御されます。
6	RESERVED	R	0x0	予約済み
5-4	RESERVED	R/W	0x0	予約済み
3	DP3_DISABLE	R/W	0x0	AUX_SNOP_DISABLE = 1b の場合に、このフィールドを使用して DP レーン 3 を有効または無効化できます。AUX_SNOP_DISABLE = 0b の場合、このフィールドを変更してもレーン 3 の機能には影響しません。 0x0 = DP レーン 3 は有効です。 0x1 = DP レーン 3 は無効化されます。
2	DP2_DISABLE	R/W	0x0	AUX_SNOP_DISABLE = 1b の場合に、このフィールドを使用して DP レーン 2 を有効または無効化できます。AUX_SNOP_DISABLE = 0b の場合、このフィールドを変更してもレーン 2 の機能には影響しません。 0x0 = DP レーン 2 は有効です。 0x1 = DP レーン 2 は無効化されます。
1	DP1_DISABLE	R/W	0x0	AUX_SNOP_DISABLE = 1b の場合に、このフィールドを使用して DP レーン 1 を有効または無効化できます。AUX_SNOP_DISABLE = 0b の場合、このフィールドを変更してもレーン 1 の機能には影響しません。 0x0 = DP レーン 1 は有効です。 0x1 = DP レーン 1 は無効化されます。
0	DP0_DISABLE	R/W	0x0	AUX_SNOP_DISABLE = 1b の場合に、このフィールドを使用して DP レーン 0 を有効または無効化できます。AUX_SNOP_DISABLE = 0b の場合、このフィールドを変更してもレーン 0 の機能には影響しません。 0x0 = DP レーン 0 は有効です。 0x1 = DP レーン 0 は無効化されます。

7.1.6 VOD_CTRL レジスタ (オフセット = 0x32) [リセット = 0x40]

VOD_CTRL を表 7-8 に示します。

[概略表](#)に戻ります。

このレジスタは、トランスミッタの出力直線性範囲を制御します。

表 7-8. VOD_CTRL レジスタ フィールドの説明

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
7-6	予約済み	R/W	0x1	予約済み

表 7-8. VOD_CTRL レジスタ フィールドの説明 (続き)

ビット	フィールド	タイプ	リセット	概要
5-4	DP_VOD	R/W	0x0	DP パスの VOD 直線性制御。 0x0 = LINR_L3 (最高) 0x1 = LINR_L2 0x2 = LINR_L1 0x3 = LINR_L0 (最低)
3-0	予約済み	R/W	0x0	予約済み

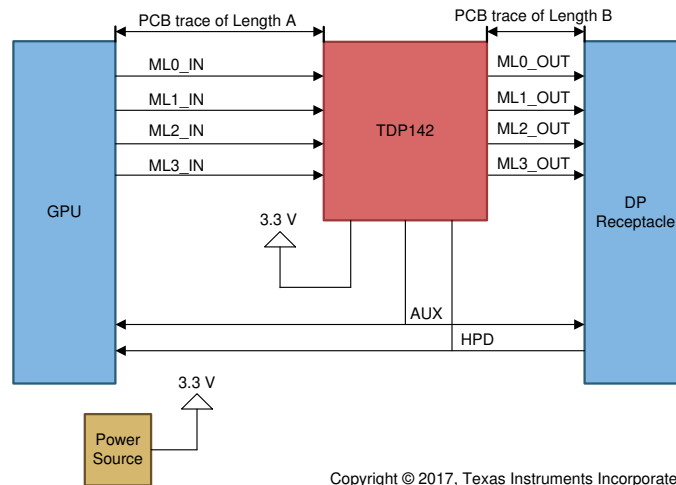
8 アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、テキサス・インスツルメンツの製品仕様に含まれるものではなく、テキサス・インスツルメンツはその正確性も完全性も保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。また、お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

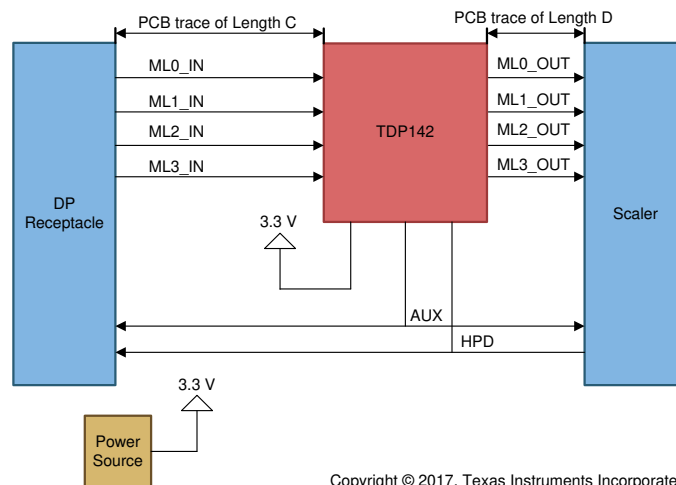
8.1 アプリケーション情報

TDP142-Q1 は、PCB パターンやケーブルなどの受動媒体を介した信号の減衰によって発生するシンボル間干渉 (ISI) ジッタを補償するように特別に設計されたリニア リドライバです。本デバイスは、ソース、シンク、ケーブル アプリケーションで使用でき、デバイスはリンクトレーニングに対して透過的です。説明のため、このセクションではソース アプリケーションとシンク アプリケーションの実装を示します。図 8-1 および図 8-2 は、それぞれ DisplayPort ソース側アプリケーションと DisplayPort シンク側アプリケーションの大きなブロック図であり、TDP142-Q1 は AUX 信号と HPD 信号の両方のチャネルをスヌーピングします。



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

図 8-1. TDP142-Q1 のソース アプリケーション



Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated

図 8-2. TDP142-Q1 のシンク アプリケーション

8.1.1 ESD 保護

TDP142-Q1 を静電放電 (ESD) から保護するために、ESD 部品を内蔵する必要がある場合があります。TI は、表 8-1 に示す ESD 保護に関する推奨事項に従うことを推奨します。クランプ電圧が表 8-1 に規定されている値よりも大きい場合、各差動ピンに R_{ESD} を接続する必要がある場合があります。ESD 部品を USB コネクタの近くに配置してください。

表 8-1. ESD ダイオードの推奨特性

パラメータ	推奨事項
ブレイクダウン電圧	DP 入力ピン用 $\geq 3.5V$ DP 以外入力ピン用 $\geq 1.5V$
I/O ライン容量	最大 5Gbps のデータレート: $\leq 0.50pF$
	5Gbps を超えるデータレート: $\leq 0.35pF$
P および N の I/O ピン間での容量の差	$\leq 0.07pF$
8A I_{pp} IO から GND へのクランプ電圧 ⁽¹⁾	$\leq 4.5V$
標準的な動的抵抗	$\leq 30m\Omega$

(1) IEC 61000-4-5 に準拠 (8/20 μs 電流波形)

表 8-2. 推奨 ESD 保護部品

メーカー	部品番号	IEC 61000-4-2 接触 $\pm 8kV$ をサポートする R_{ESD}
Nexperia	PUSB3FR4	1 Ω
Nexperia	PESD2V8Y1BSF	1 Ω
テキサス・インスツルメンツ	TPD1E04U04DPLR	2 Ω
テキサス・インスツルメンツ	TPD4E02B04DQAR	2 Ω

8.2 代表的なアプリケーション

8.2.1 ソース アプリケーションの実装

図 8-3 に、ソース側アプリケーションの回路図を示します。TDP142-Q1 は、DisplayPort グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) と DisplayPort レセプタクルとの間に配置されます。SNOOPENZ が Low のとき、TDP142-Q1 はパワー マネージメントのために AUX トラフィックを監視します。

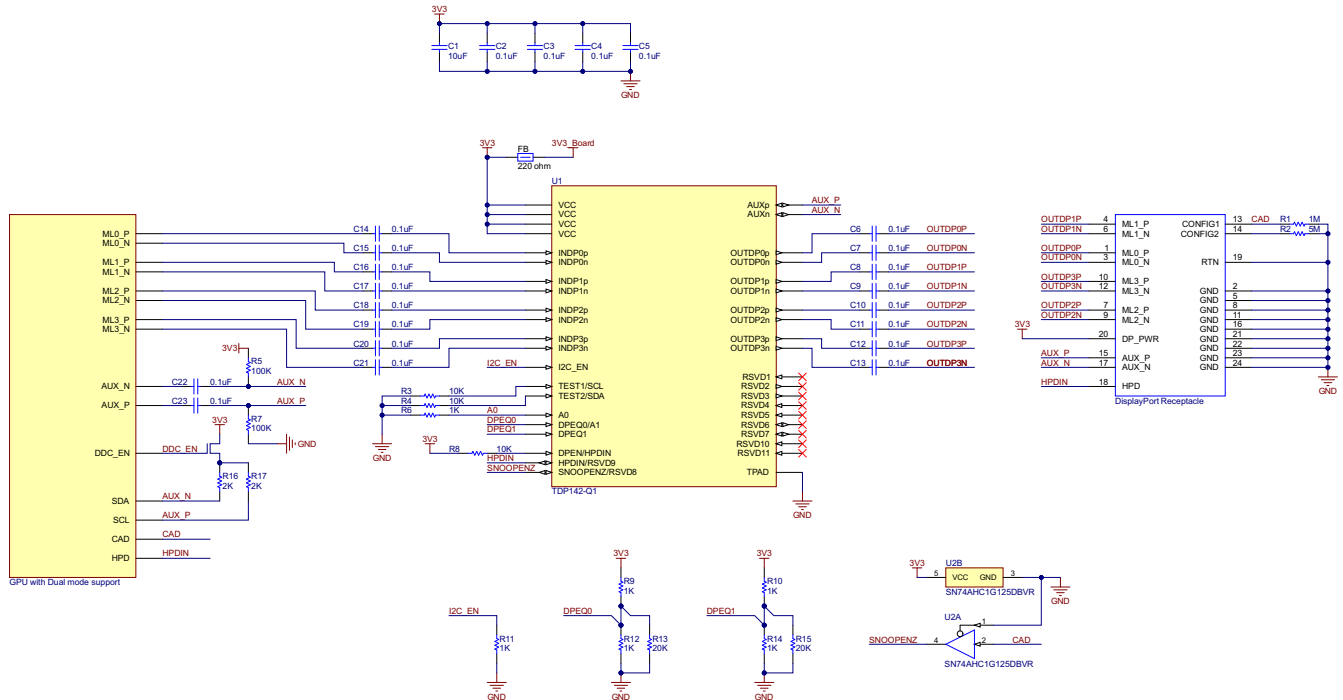


図 8-3. DisplayPort ソース アプリケーションのブロック図

8.2.1.1 設計要件

TDP142-Q1 は多くの種類のアプリケーションに設計できます。すべてのアプリケーションには、システムが正常に動作するための特定の要件があります。たとえば、ソース アプリケーションは、シンク アプリケーションとは異なるハードウェア構成を HPD チャネルおよび AUX チャネルで使用します。このデバイスは I²C を使用して構成可能です。ただし、I²C として GPIO 構成が提供されている場合は、必ずしも利用できるわけではありません。さらに、ソースの命名規則が異なる場合があるため、ソースとレセプタクル間のリンクが TDP142-Q1 を介して正しくマッピングされていることを確認してください。

表 8-3. 設計パラメータ

パラメータ	値
最大動作データレート (RBR, HBR, HBR2, HBR3)	HBR3 (8.1Gbps)
電源電圧	3.3 V
A のパターン長と幅	12 インチと幅 6 mil
B のパターン長と幅	2 インチと幅 6 mil
メインリンク AC デカップリング コンデンサ (75nF~265nF)	100nF を推奨
制御モード (I ² C または GPIO)	GPIO (I2C_EN = 0)
デュアル モード DisplayPort のサポート(はい/いいえ)	はい。SNOOPENZ は、バッファ経由で CONFIG1 に接続する必要があります。

8.2.1.2 詳細な設計手順

TDP142-Q1 を使用して設計を行うには、以下の要件が必要です。

- DisplayPort 入力 (A) および出力 (B) チャンネルの損失プロファイルを決定します。6mil パターン挿入損失については、[図 8-5](#) を参照してください。
- 損失プロファイルに基づいて、TDP142-Q1 が電氣的規格に準拠するために最適な構成を決定します。DPEQ[1:0] は適切な値に設定する必要があります。この場合、12 インチの FR4 パターンは、4.05GHz で約 8dB の損失に相当します。そのため、DPEQ1 20kΩ をグラウンドに、DPEQ0 1kΩ をグラウンドに接続します。
- AC カップリング コンデンサ、制御ピン抵抗、および推奨のデカップリング コンデンサを VCC ピンからグラウンドに使用するソース アプリケーションの詳細については、[図 8-3](#) を参照してください。
 - AUX:AUXP に 100kΩ プルダウン抵抗、AUXN に 100kΩ プルアップ抵抗があることを確認します。これらの 100kΩ 抵抗は、100nF コンデンサの TDP142-Q1 側に配置する必要があります。
 - HPDIN は、省電力のために DisplayPort 機能を有効または無効にするために使用されます。GPIO/I²C モードに基づいて、HPD 信号をピン 23 またはピン 32 に配線します。

表 8-4. HPD GPIO/I²C の選択

モード	HPD
GPIO (I2C_EN = 0)	ピン 32
I ² C (I2C_EN != 0)	ピン 23

- デュアル モード DisplayPort をサポートするアプリケーションの場合：SNOOPENZ ピンは、SN74AHC125 などのバッファを介して、DisplayPort レセプタクルの CONFIG1 に接続する必要があります。デュアル モードアダプタが DisplayPort レセプタクルに接続されている場合、SNOOPENZ ピンの内部プルダウンが強すぎて有効な VIH を登録できないため、バッファが必要です。
- GPIO 端子または I²C インターフェイスを使用して TDP142-Q1 を構成します。
 - GPIO - 端子 DPEQ0 および DPEQ1 を使用。
 - I²C – 詳細な構成手順については、[I2C レジスタ マップ](#)と[プログラミング](#)セクションを参照してください。
- サーマル パッドはグラウンドに接続する必要があります。

8.2.2 シンク アプリケーションの実装

図 8-4 は、シンク アプリケーションの回路図です。TDP142-Q1 の左側は DisplayPort レセプタクルに接続され、TDP142-Q1 の右側は Scaler または DisplayPort シンクに接続されています。

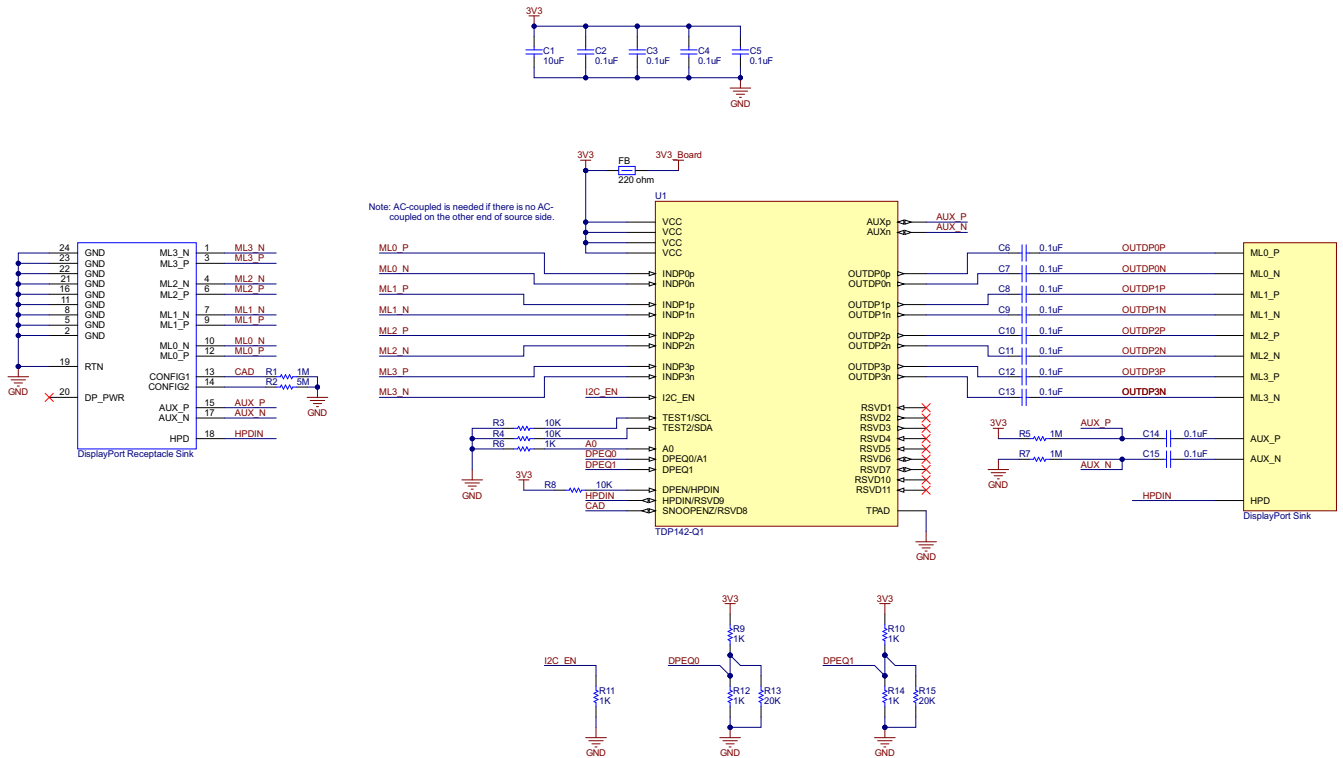


図 8-4. DisplayPort シンク アプリケーションのブロック図

8.2.2.1 設計要件

この設計例では、表 8-5 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-5. 設計パラメータ

パラメータ	値
最大動作データレート (RBR、HBR、HBR2、HBR3)	HBR3 (8.1Gbps)
電源電圧	3.3 V
C のパターン長と幅	12 inch/6 mil
D のパターン長と幅	2 inch/6 mil
メインリンク AC デカップリング コンデンサ (75nF~265nF)	100nF を推奨
制御モード (I ² C または GPIO)	GPIO (I2C_EN = 0)

8.2.2.2 詳細な設計手順

シンクアプリケーションの設計手順を以下に示します。

- DP 入力 (C) と出力 (D) のチャンネルとケーブルの損失プロファイルを決定します。6mil パターン挿入損失については、[図 8-5](#) を参照してください。
- 損失プロファイルに基づいて、TDP142 が電氣的規格に準拠するために最適な構成を決定します。
- AC カップリング コンデンサ、制御ピン抵抗、および推奨のデカップリング コンデンサを VCC ピンからグランドに使用するソースアプリケーションの詳細については、[図 8-4](#) を参照してください。
 - AUX:AUXP に 1MΩ プルアップ抵抗、AUXN に 1MΩ プルダウン抵抗があることを確認します。1MΩ 抵抗は、100nF コンデンサの TDP142-Q1 側に配置する必要があります。
 - HPDIN:GPIO/I2C モードに基づいて、HPD 信号をピン 23 またはピン 32 に配線します。このセットアップにより、TDP142-Q1 はソースが接続されていないときに電力を節約できます。

表 8-6. HPD GPIO/I2C の選択

モード	HPD
GPIO (I2C_EN = 0)	ピン 32
I2C (I2C_EN != 0)	ピン 23

- GPIO 端子または I²C インターフェイスを使用して TDP142-Q1 を構成します。
 - GPIO - 端子 DPEQ0 および DPEQ1 を使用。
 - まず、13dB や 15dB などの高いイコライゼーション値を開始し、必要に応じて値を調整することを推奨します。
 - I²C – 詳細な構成手順については、[I2C レジスタ マップ](#)と[プログラミング](#)セクションを参照してください。
- サーマル パッドはグランドに接続する必要があります。

8.2.3 アプリケーション曲線

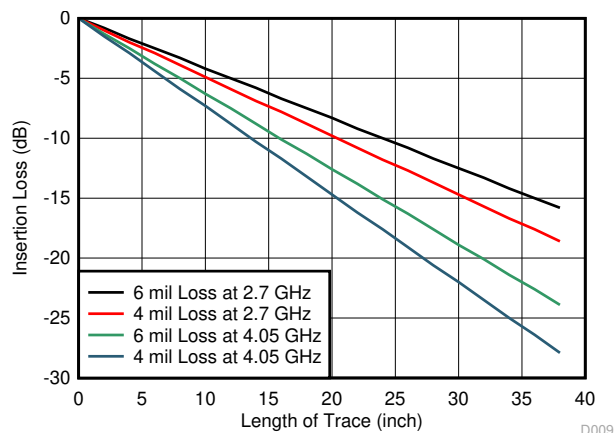


図 8-5. FR4 PCB パターンの挿入損失

8.3 電源に関する推奨事項

TDP142-Q1 は、3.3V 電源で動作するように設計されています。[絶対最大定格表](#)に記載されているレベルより上のレベルは使用しないでください。アプリケーションに高電圧のシステム電源が使用される場合は、電圧レギュレータを使用して 3.3V に降圧してください。ノイズを低減し、電源の整合性を向上させるためにデカップリング コンデンサを使用します。各電源ピンに 0.1μF コンデンサを使用します。

8.4 レイアウト

8.4.1 レイアウトのガイドライン

1. INDP[3:0]P/N and OUTDP[3:0]P/N のペアは、制御された 100Ω の差動インピーダンス ($\pm 10\%$) で配線します。
2. その他の高速信号から遠ざけます。
3. ペア内の配線を 5mil 以内に抑えます。
4. [DisaplyPort 設計ガイド](#)に従って、ペア間スキューを 2 UI 以内に抑えます
5. 配線長を一致させるための調整は、配線長の不一致が発生している場所の近くで行います。
6. 各ペアは、信号配線幅の 3 倍以上離す必要があります。
7. 差動配線での曲げの使用は最小限に抑えます。曲げを使用する場合、左右の曲げの数は可能な限り等しくし、曲げの角度は 135 度以上としてください。この設定により、曲げに起因する長さの不一致が最小限に抑えられ、その結果、曲げが EMI に及ぼす影響が最小限に抑えられます。
8. すべての差動ペアは同じ層に配線します。
9. ビアの数 を最小限に抑えます。ビアの数を 2 以下にすることを推奨します。
10. デバイスの出力ピンとコネクタとの間の順序が一致していないため、レイアウトでは OUTDP2 と OUTDP3 で信号が交差する可能性があります (図 8-7 を参照)。オプションの 1 つは、GPU が BGA パッケージである場合にデバイスの入力 で極性をスワップし、使用するビアの数を最小限に抑えることです。
11. グランド プレーンに隣接する層に配線を配置します。
12. 差動ペアは、プレーンの割れ目の上には配線しないようにします。
13. なお、テスト ポイントを追加することは、インピーダンスの非連続性をもたらすため、信号性能に悪影響を及ぼします。テスト ポイントを使用する場合、テスト ポイントを連続的かつ対称的に配置します。差動ペアにスタブを形成するような方法で、テスト ポイントを配置するべきではありません。

8.4.2 レイアウト例

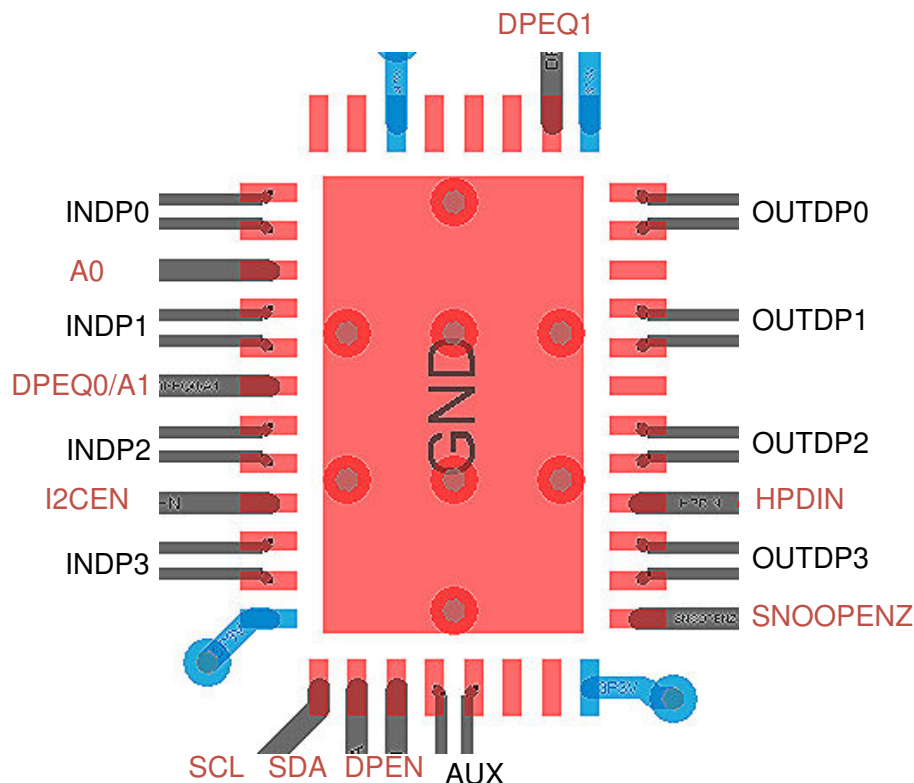


図 8-6. レイアウト例

以下の図は、BGA パッケージを使用して、デバイスの出力とソースの DisplayPort コネクタとの間の不一致順序を調整する方法を示しています。図 8-7 に、TDP142-Q1 とコネクタとの間の交差セクションを示します。通常、交差を避けるためにビアを使用しますが、ビアを使用するとシグナル インテグリティが減衰する可能性があります。したがって、TDP142-Q1 の入力に極性スワップを実装できます。図 8-8 に、TDP142-Q1 とコネクタとの間に交差セクションがなくなることを示しています。このため、使用するビアの数を最小限に抑えることができます。このオプションは、BGA パッケージを使用しているソースにのみ有用であることに注意してください。

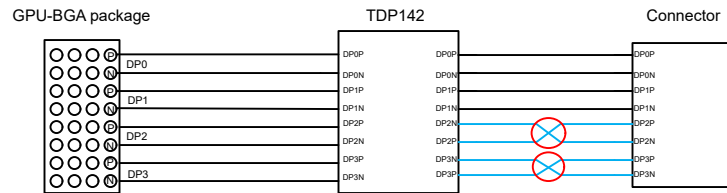


図 8-7. レイアウト例：出力側での信号交差

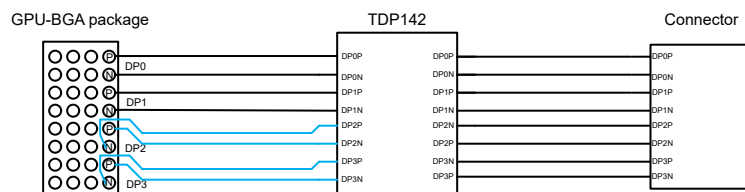


図 8-8. レイアウト例：INDP2 と INDP3 の極性スワップ

9 デバイスおよびドキュメントのサポート

9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

9.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

9.3 商標

DisplayPort™ is a trademark of VESA.

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

HDMI® is a registered trademark of HDMI Licensing LLC.

VESA® is a registered trademark of Video Electronics Standards Association.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

9.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

9.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (November 2024) to Revision A (February 2025)

Page

• データシートのステータスを「事前情報」から「量産データ」..... 1

11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TDP142RGFRQ1	Active	Production	VQFN (RGF) 40	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TDB461
TDP142RGFRQ1.B	Active	Production	VQFN (RGF) 40	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TDB461
TDP142RGFTQ1	Active	Production	VQFN (RGF) 40	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TDB461
TDP142RGFTQ1.B	Active	Production	VQFN (RGF) 40	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TDB461

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TDP142-Q1 :

- Catalog : [TDP142](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TDP142RGFRQ1	VQFN	RGF	40	3000	330.0	16.4	5.25	7.25	1.45	8.0	16.0	Q1
TDP142RGFTQ1	VQFN	RGF	40	250	180.0	16.4	5.25	7.25	1.45	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TDP142RGFRQ1	VQFN	RGF	40	3000	367.0	367.0	35.0
TDP142RGFTQ1	VQFN	RGF	40	250	210.0	185.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW

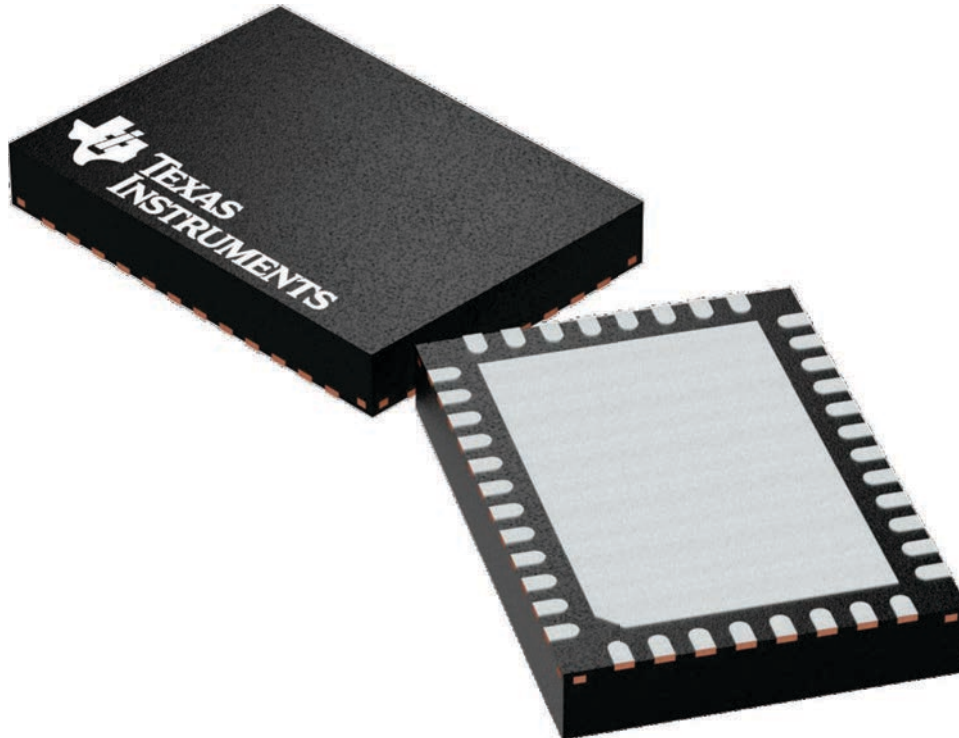
RGF 40

VQFN - 1 mm max height

5 x 7, 0.5 mm pitch

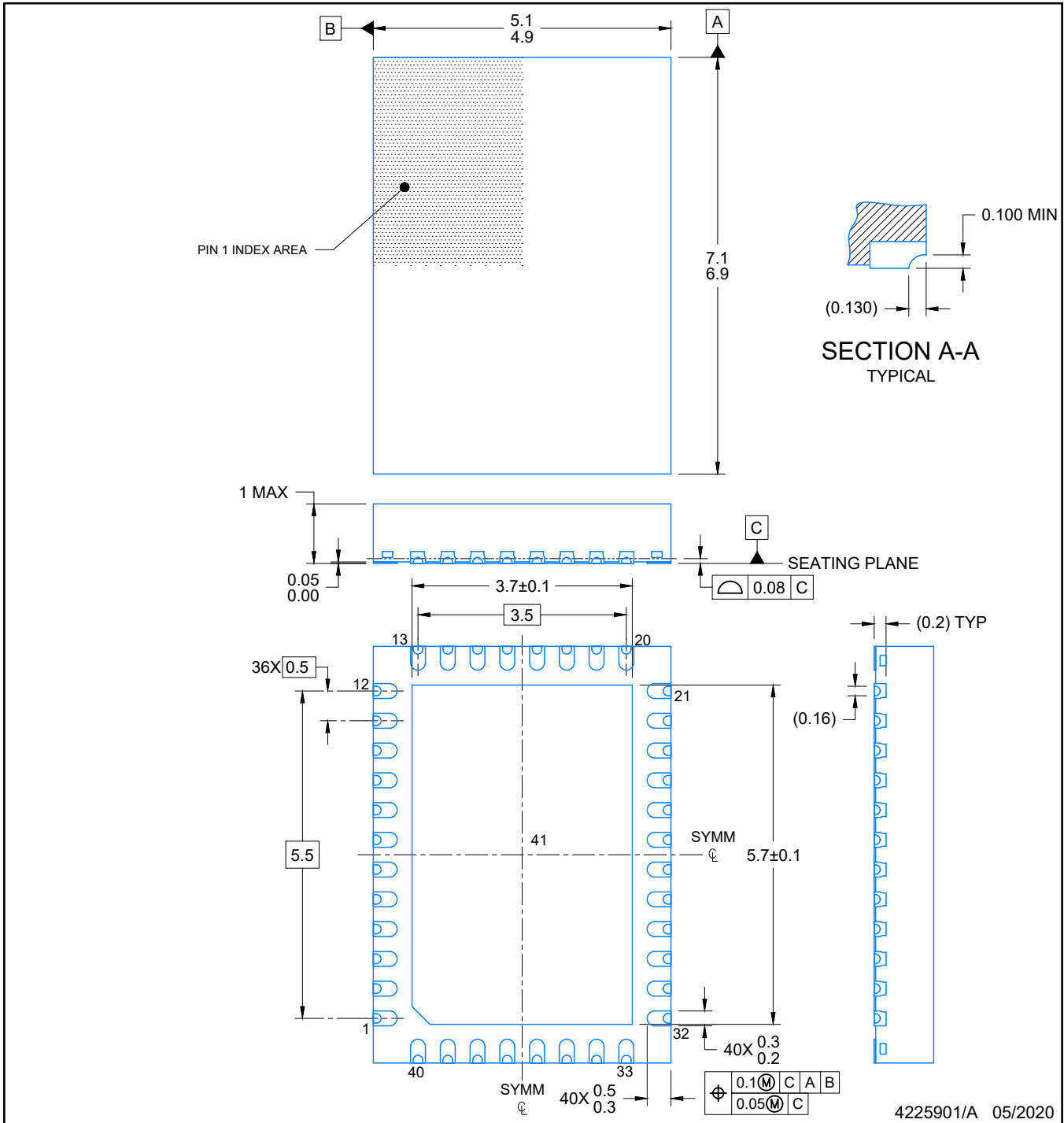
PLASTIC QUAD FLAT PACK- NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4225115/A

PLASTIC QUAD FLATPACK- NO LEAD



NOTES:

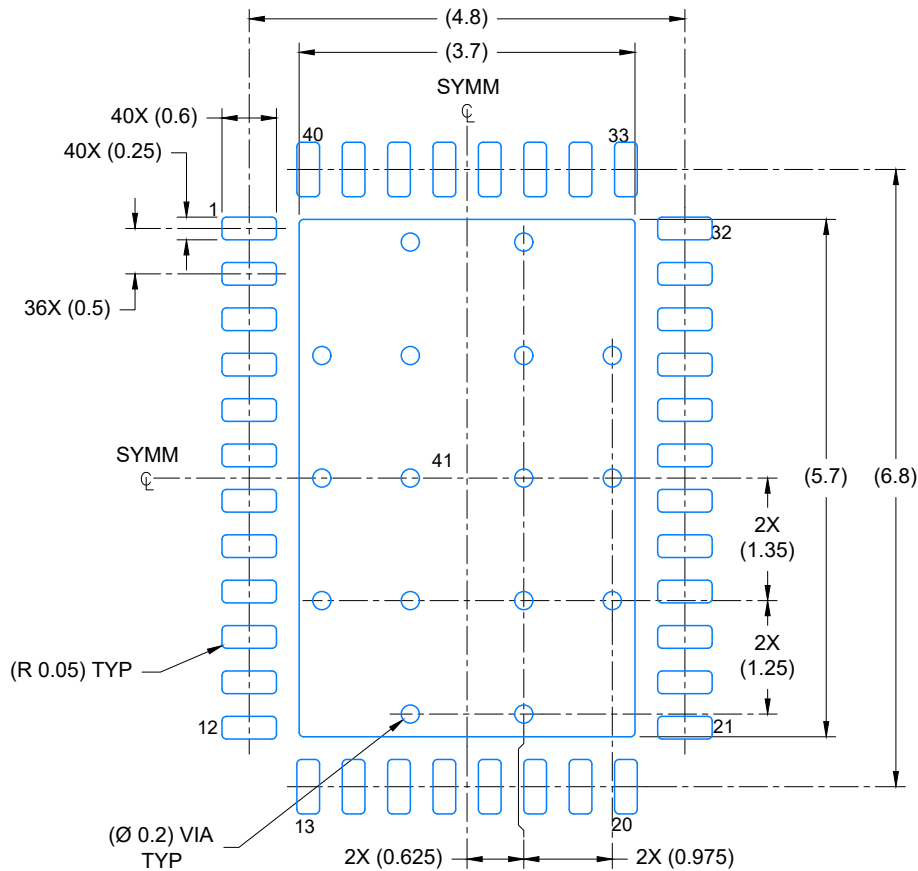
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

VQFN - 1 mm max height

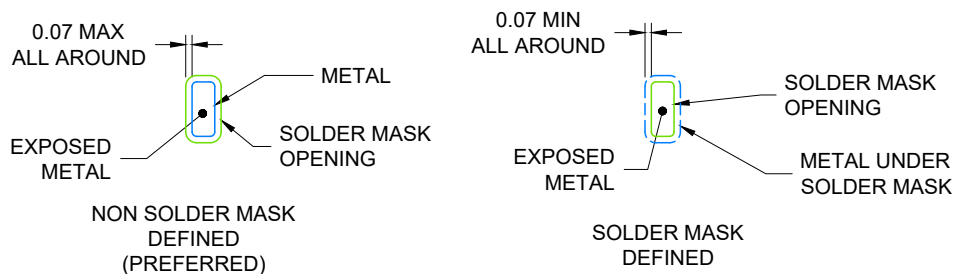
RGF0040F

PLASTIC QUAD FLATPACK- NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE

EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 12X



SOLDER MASK DETAILS

4225901/A 05/2020

NOTES: (continued)

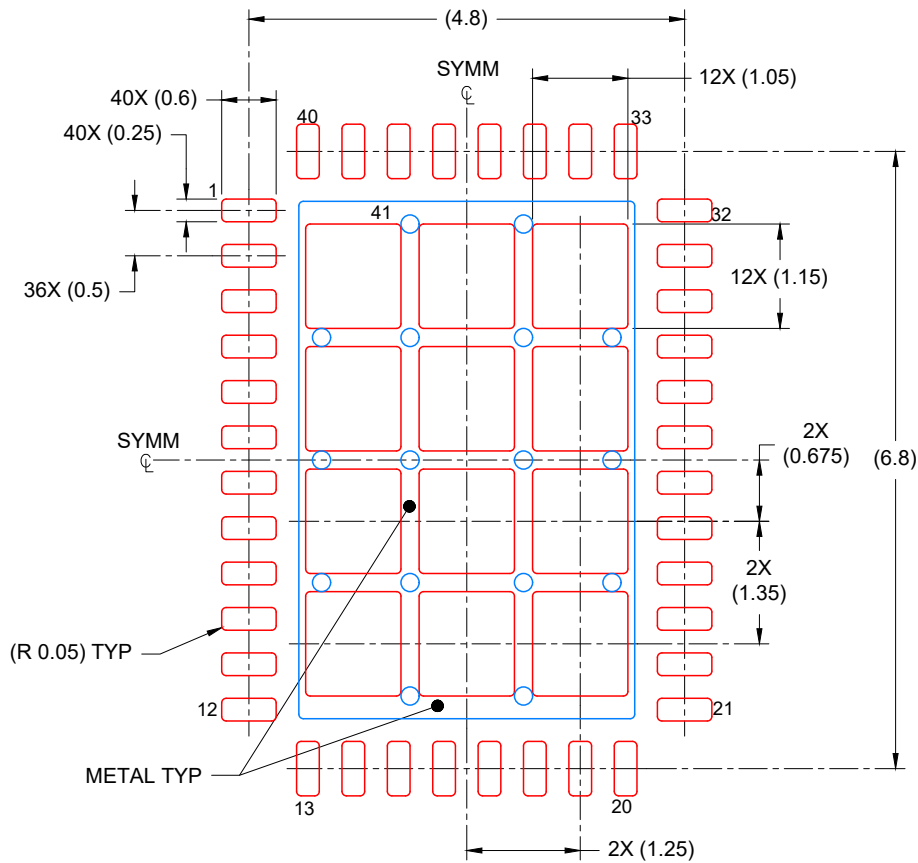
- This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
- Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RGF0040F

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK- NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
69% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 12X

4225901/A 05/2020

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月